



JOURNEE TECHNIQUE

Action Concertée Packaging (AC-PAC) du PEPR électronique

Objectif : Présentation de l'Action Concertée Packaging (AC-PAC) et rencontre des acteurs Français



13h45 – 14h00	Accueil	
14h00 - 14h05	Mot de bienvenue et introduction de la journée	Jean-Charles Souriau Président du chapitre IEEE EPS France
14h05 - 14h30	Le packaging au cœur de l'innovation	Perceval Coudrain (CEA-Leti)
14h30 – 15h00	Présentation générale du PEPR-PAC	Hugues Granier (CNRS-LAAS)
15h00 – 15h30	Etat des lieux Français du packaging pour la microtechnologie	David Henry (CEA-Leti)
15h30 -16h15	Pause-café autour des posters de laboratoires participants au PEPR-PAC	Acteurs du PEPR
16h15 -17h30	Table ronde <i>Modérateurs: Jean-Charles Souriau et David Henry</i>	Romain Coffy (Responsable R&D Packaging / ST Microelectronics) Wilfrid Aklamavo (Responsable engineering / SERMA) Sylvie Joly (Responsable des partenariats 3D Integration & packaging / CEA-Leti) Wilson Maia (Expert en Packaging Avancé et Fiabilité /Thales) Abdelkrim Talbi (Professeur à Centrale Lille), Cecile Ghouila (Maître de conférences à Centrale Lille)

*Evènement organisé la veille de la conférence
IMAPS MINAPAD -7 & 8 juin 2023*



14h > 17h30

WTC / Congress center
5 -7 , place Robert Schuman
38025 Grenoble / FRANCE

Mardi
6 juin
2023

Inscription gratuite

Contactez: **Jean-Charles Souriau** jcsouriau@cea.fr